

Advantech (TWSE:2395)

1H & 2Q 2026 Investor Conference Call Transcript (Summary)

Date: August 5, 2026 | Time: 14:00 Taipei Time

1H26 Revenue	Gross Margin	Operating Margin	EPS
\$46.512 BN	38.3%	19.0%	\$9.05
<i>+32% YoY</i>			

CALL PARTICIPANTS

Corporate Executives

- **KC Liu** – *Chairman*
- **Eric Chen** – *CFO & President of General Management*
- **Linda Tsai** – *President of Intelligent System & COO*
- **Miller Chang** – *President of Embedded Sector*
- **Grace Liao** – *Deputy Spokesperson and Sr. IR Manager*

SAFE HARBOR STATEMENT & FORWARD-LOOKING DISCLAIMER

This transcript has been prepared based on the audio recording of the conference call and has been edited for clarity and readability, including the removal of repetitive wording and conversational fillers. While reasonable efforts have been made to ensure its accuracy, the transcript may contain transcription errors or omissions. In the event of any discrepancy, the original audio recording and the Company's official filings and disclosures shall prevail. This transcript is provided for reference only and does not constitute investment advice or an offer or solicitation to buy or sell any securities.

MANAGEMENT PRESENTATION

Grace Liao – Deputy Spokesperson and Sr. IR Manager

研華 2026 年第二季暨上半年營收與獲利皆創歷史新高。第二季營收達新台幣 261.3 億元，年增 46%、季增 28%，並優於原先財測；營業毛利為 98.5 億元，毛利率 37.7%。在嚴謹費用控管下，營業費用為 47.2 億元，費用率由去年同期的 22.5%大幅降至 18.1%；營業利益達 51.3 億元，營業利益率為 19.6%，年比及季比均顯著提升。第二季有效稅率為 19.4%，稅後淨利達 45.2 億元，年增 127%，單季 EPS 為 5.20 元。

累計上半年營收達 465.12 億元，年增 32%；營業毛利為 178.3 億元，毛利率 38.3%，年減 1.9 個百分點，主要受到料件成本上揚影響，但受惠於費用有效控管，營業利益率仍達 19%。上半年稅後淨利為 78.5 億元，年增 66%，累計 EPS 達 9.05 元。

以美元計算，上半年營收為 14.7 億美元，年增 33%，所有區域市場均呈現雙位數成長；北美、歐洲及中國三大市場合計營收貢獻維持約七成，其中中國市場成長幅度優於整體，營收占比提升至 24%。北美市場成長 30%，主要受惠於半導體設備、機器人及雲端網絡設備專案；歐洲成長 29%，由醫療設備、工業自動化及監控系統專案帶動；中國大幅成長 51%，主要受惠於通路銷售強勁，以及半導體、機器人與能源專案快速成長；台灣市場成長 67%，主要來自半導體設備及自動化設備專案。各事業體方面，IoT Automation 成長 19%，受自動化設備及交通專案帶動；Intelligent Systems 成長 34%，主要受惠於半導體設備業務在北美、中國、歐洲及台灣均呈現高雙位數增長，雲端網絡設備亦表現良好；Embedded Sector 成長 28%，智慧醫療、自動化設備及 Robotics 專案需求持續暢旺；Applied Service 成長 2%，其中歐洲及中東智慧醫療專案持續增溫，但整體表現受到缺料影響。

資產負債表方面，存貨占總資產比重升至 22%，存貨周轉天數為 101 天，均較上季及去年同期略增，主要反映備料成本上升，公司仍維持嚴謹的庫存管理。現金循環週期維持在 82 天的良好水準，顯示營運節奏穩定，資金運用效率與財務結構維持健康。

Eric Chen – CFO & President of General Management

研華上半年營運表現亮眼，主要受惠於 AI 基礎建設，以及 Edge AI / Physical AI 兩大成長引擎，並持續推進軟硬體整合與 IWS 布局。營運面仍需關注毛利率及存貨水準：第二季毛利率由過往約 40%降至 37.7%，主要因部分零組件價格上漲達數倍，雖公司具備成本轉嫁能力，但實際加價幅度約 5%至 10%，無法完全依照原有毛利率加成，因而稀釋整體毛利率；待原物料漲勢趨緩後，毛利率可望逐步回升。存貨較去年同期增加，其中 38%來自 DDR4、SSD 等料件價格上漲，另外 62%則因營運成長帶動備貨數量增加。

接單方面，第二季北美、歐洲及中國大陸 B/B Ratio 分別達 1.92、1.25 及 1.21，整體為 1.44；接單已連續四季正成長，出貨亦連續三季成長，考量接單至出貨約需四至六個月，且目前部分料件交期進一步延長，公司對第三季及第四季營收表現維持樂觀看法。

區域展望方面，預期美國、台灣及日本營收均可望呈現年比及季比雙位數成長；中國、歐洲及韓國預估年比雙位數成長、季比個位數成長；中東則因一項醫療專案接近產品生命週期終點，營收可能年比衰退。受台灣主管機關規定限制，公司無法提供明確季度財測，但預期第三季合併營收將優於第二季，毛利率及營業利益率則大致維持第二季水準。公司亦新增 Design-Win Indicator 作為營運觀察指標，上半年北美、歐洲及中國大陸合計取得 123 個 Design-Win 專案，預估可帶來約 4.44 億美元年營收，其中北美全年 Design-Win 潛在年營收有望達約 9 億美元。

產能布局方面，研華於北美投資約 9,700 萬美元興建 Tustin 新營運據點，包含辦公大樓及倉庫，預計 10 月 20 日正式啟用；倉庫已於 5 月底取得 ISO 認證，目前已有 33 項客戶專案移轉至當地生產及出貨，預估今年至少可貢獻 6,000 萬美元出貨，後續將逐步放量。北美研發與組裝服務目前主要集中於北加州 Milpitas，未來南加州 Tustin 據點將進一步擴充產能，整體布局可望支撐北美營收成長至 15 億美元。台灣華亞新廠總投資接近新台幣 40 億元，目前工程進度約 42%，預計 2028 年第一季完工，樓地板面積約當現有林口製造中心，將支應公司至 2030 年的成長需求；未來製造產值配置預計台灣與中國各約占 42%至 43%、日本約 10%，其餘約 5%由馬來西亞等第三地外包產能支應。此外，公司亦投入 55 億日圓翻新 2019 年收購的日本北九州直方廠，預計 2028 年完工，主要服務日本在地客戶，並可作為「Taiwan Plus One」的備援製造基地；完工後日本產值占比預計可達 6%至 7%，至 2030 年進一步提升至約 10%。

Linda Tsai – *President of Intelligent System & COO*

AIGC 相關需求持續帶動研華今年營運成長，主要涵蓋半導體設備、晶圓廠 (Fab) 自動化、高階運算、AOI 及 Semi-Rig 等新產品與應用；同時，公司亦持續深耕既有電力與能源市場，提供從 OEM 設備到 OT 端運維管理的完整解決方案。研華透過既有產品組合，結合 OEM 廠商及自動化系統整合商 (SI)，與客戶共同掌握本波新增商機，預期相關需求與半導體業務的成長動能將延續至今年及明年。目前需求主要來自北美市場，受惠於美國四大 CSP 持續投入大規模資本支出；此外，研華客戶亦持續於亞洲及歐洲擴充據點，相關商機並不限於北美。

供應鏈方面，今年整體環境仍具挑戰，自去年底以來，Memory、SSD 及 PCB 等關鍵料件交期持續延長。為縮短整體生產交期，除規劃未來產能投資外，公司亦運用海外據點進行快速且彈性的組裝；在料件管理上，研華已將策略性零組件的下單週期由原本 6 至 8 個月延長至 12 至 18 個月，透過提早下單提升取得供應的機會。同時，公司亦與策略供應商洽談長期供貨協議 (LTA) 及採購承諾等合作安排，以確保 2027 年重要料件供應能夠符合研華的營運需求。

Miller Chang – *President of Embedded Sector*

研華上半年營運表現良好，核心策略為將 Edge AI 進一步延伸至 Physical AI，推動 AI 技術於產業端落地並實現具體商業價值。目前公司已將 Edge AI 與 Physical AI 相關設備導入半導體設備、工廠自動化、醫療及零售等既有市場，並積極拓展能源、機器人等新興應用。Edge AI 為研華核心業務基礎，根據 Market.US 報告，全球 Edge AI 市場規模預計於 2034 年達 1,961 億美元，年複合成長率為 23.8%；其低延遲、資料隱私及即時反應等特性，使邊緣運算硬體在 AI 產業發展中仍占有重要地位，但產業亦面臨軟體開發、規模化部署及軟硬體整合等挑戰。隨著 AI 發展由 Cloud AI、Generative AI 及 LLM 進一步演進至 Agentic AI，Edge AI 將成為 AI 技術落地至各產業的重要基礎，而 Physical AI 則可透過感知、決策及執行能力，實際應用於機器人、智慧工廠、能源及醫療人機協作等場景，進一步改變產業生態。為協助客戶加速 AI 落地，研華已建立完整的三層 Edge AI 硬體架構：第一層為 Edge AI Embedded，透過 AI 加速模組快速導入既有工業電腦及邊緣運算設備，提升 AI 運算效能；第二層為 Edge AI Appliance，針對醫療、機器人及能源等產業提供專用設備；第三層為 Edge AI Server，支援企業於本地端進行資料運算與保存，降低將資料傳送至雲端的需求。目前邊緣運算事業體已貢獻公司近 50% 的營收。在軟體方面，研華推出 WEDA (WISE Edge Developer Architecture)，以標準化、容器化的軟體架構整合於各類硬體平台，協助開發者、客戶及合作夥伴加速 Edge AI 應用部署。平台策略上，公司持續與主流晶片供應商合作，因應運算架構由過去以 Intel x86 為主，逐步發展為 AMD 高階運算、Qualcomm 及 Rockchip 等 Arm 架構，以及 NVIDIA AI 晶片與 CUDA 開發者生態系並存的多元競爭格局，藉此提供即時且具效能的 Edge AI 運算平台，維持在多元晶片架構下的市場競爭力。

KC Liu – *Chairman*

研華在 B2B 市場主要聚焦六大垂直應用，包括智慧製造、機器人與自動化、能源與公用事業、醫療、智慧城市與公共服務，以及零售與服務業。目前以能源與公用事業的業務規模最大，智慧製造市場亦具相當規模，但產業升級速度相對較慢；機器人與自動化則涵蓋倉儲及產線無人化等應用。醫療市場受護理人力短缺影響，AI 可協助自動化部分工作，使護理人員專注於關鍵病患照護，公司亦設有專責部門耕耘相關商機。智慧城市與公共服務涵蓋交通、城市管理及自動收費等應用，目前仍處於早期階段，未來成長將取決於政府投資與商業收費模式的建立；零售與服務業雖已有許多 AI 應用討論，但實際導入仍有限，主要因投資效益尚未明確，目前效益多集中於節省人力，未來若 AI Agent 能進一步帶動營收成長，導入速度可望加快。軟體布局方面，研華目前約有 300 多名專職軟體研發人員，主要發展 WISE 與 WEDA 兩大系列；WISE 聚焦 AI 應用架構及應用軟體，WEDA (WISE Edge Developer Architecture) 則將研華旗下不同晶片及功能的硬體平台容器化並串接 WISE 架構，讓全球開發者能更便利地將硬體整合至產業系統。目前 WEDA 隨硬體免費提供，未來若推出更進階版本，再評估收費模式。由於軟體開發必須貼近實際應用及客戶需求，公司未來將採取更國際化的研發與合作模式，可能於印度、歐洲等市場與客戶及合作夥伴共同開發。經營模式方面，研華近期提出 IWS (Integrated WISE Solution & Station) 概念，將伺服器、邊緣硬體、WISE 軟體及 AI Agent 整合為可直接部署於客戶現場的軟硬

體一體機，改變過去分別銷售硬體與軟體、再由客戶或系統整合商自行整合的模式，降低產業客戶導入 AI 的技術門檻。IWS 前端可連結大型語言模型，並依智慧工廠、能源、醫療及零售等不同垂直領域配置相應的 Domain AI Agent、產業技能及在地小型模型，讓客戶在既有平台上進一步加入自身知識與應用，建立企業專屬的 AI Agent。公司將運用既有超過 40 年的 Server、IPC、Edge 與 HMI 硬體基礎，以及過去七至八年累積的 WISE 軟體能力，並與各國、各產業的系統整合商深度合作，共同開發 Domain Skills 及產業 AI Agent。IWS 被視為研華切入 B2B AI 應用層的重要長期布局，但仍需一至兩年耕耘，現階段對營收貢獻有限，並非上半年業績成長的主要來源。未來 IWS 將形成不同於傳統硬體銷售的新商業模式，單一客戶的採購套數可能有限，並依運算需求每兩至三年擴充，但由於方案整合伺服器、軟體與服務，單套營收與毛利貢獻可望維持一定水準。公司未來亦將由以自行開發及銷售為主的模式，進一步轉向生態系合作，持續進行大型客戶硬體 Design-in，同時導入美國及中國市場的基礎 AI 軟體，並與垂直產業 SI 合作，將客戶的產業知識及技能部署於廠區內的在地伺服器，提供後續維運與應用服務，使更多運算由資料中心下沉至企業端，在強化資料掌控與即時運算能力的同時，也可能降低雲端 Token 使用量，推動工業 AI 應用進入下一階段。

QUESTION & ANSWER SESSION

本次會議問答係綜整公司與各投資機構持續交流及議合所蒐集之重點議題，提問來源包括但不限於 UBS, Morgan Stanley, Daiwa, 富邦證券, 群益投顧, 永豐投顧, 凱基投顧...等機構投資人。

Financial & Outlook

[1.1] 下半年營收動能及訂單需求是否維持暢旺? 在上半年強勢提前拉貨下，下半年客戶下單是否有趨緩情形?

[1.2] 研華營收持續創高，是否多為漲價效應的受惠，實際貢獻的量跟價應該怎麼看?

[1.3] 研華目前各廠區產能及稼動率狀況為何? 是否可以持續支應未來出貨達交率?

Eric Chen – CFO & President of General Management

研華第三季需求及接單動能維持強勁，預期營收無論年比或季比均將成長，且增幅不低；第四季則暫不提供預估。7 月接單金額再創新高，達 5.74 億美元，B/B Ratio 約 1.64，高於第二季的 1.44，但訂單暢旺也使料件供應成為後續出貨的主要挑戰。營收成長結構方面，上半年美元營收年增 33.2%，其中價格因素貢獻 12.8 個百分點，主要反映 DDR4、SSD 等料件漲價後向客戶進行價格調整；其餘 20.4 個百分點則來自出貨量及產品組合改善。整體而言，營收增幅約 38% 來自價格、62% 來自銷量及產品組合。產能方面，第二季昆山、台灣及日本北九州廠的稼動率分別約為 106%、94.1% 及 94.7%；預估第三季昆山將提高至 106% 至 110%、台灣升至 105% 至 110%，日本則約為 95% 至 100%，公司可透過加班及部分委外生產因應高稼動率及訂單需求。目前主要風險仍集中於關鍵零組件供應，其中 PCB 缺料情況可能進一步加劇，Intel CPU 及部分 Power IC 亦有供應短缺；SSD 與 DDR4 供應狀況則較先前改善。此外，整體料件交期持續拉長，公司後續營運重點將在於縮短關鍵零組件交期並確保供應，以支應強勁接單及後續出貨需求。

Material Cost Impacts & Reactions

2.1 毛利率短期受原物料成本波動，季對季持續下滑，毛利率預計何時回到以往水準區間？

2.2 目前長短料況除了記憶體外，其他的料況目前供應/漲價狀況是否會影響出貨？轉嫁策略是否還能持續奏效？

2.3 請問第三季備料情況與第二季相比，備料率差不多嗎？

■ **Eric Chen** – CFO & President of General Management & **Linda Tsai** – President of Intelligent System

第二季毛利率有所下滑，主要因 Memory、SSD 等部分關鍵零組件價格大幅上漲，公司雖具備向客戶轉嫁成本的能力，但考量客戶接受度，難以按照過往相同的毛利率進行加價，僅能採取有限幅度的 Mark-up，因而對整體毛利率產生稀釋效果。未來待原物料價格漲勢逐步趨緩，毛利率可望開始回升；目前部分料件價格及供應已有降溫跡象，但 NVIDIA、Intel 等供應商近期可能啟動新一波漲價，因此公司預期第三季毛利率將大致維持第二季水準。料件供應方面，Memory 與 SSD 等 Commodity 料件的供應緊張情況已明顯緩解，其中部分寬溫、工規 SSD 預計至第四季可望進一步改善；公司透過與多家策略供應商合作，整體供應已逐步趨於穩定。相較之下，下半年較需關注專用料件，尤其 PCB 受上游材料短缺及部分供應商停產影響，第四季供應可能更具挑戰。公司將持續與供應商合作，並由研發單位加速驗證替代材料及第二供應來源；其他料件雖亦有零星缺貨，包括部分較低核心數的 CPU，但目前仍在可控範圍內，且 CPU 供應預期第四季可望改善。整體而言，第三季所需材料大致準備完成，供應應無重大問題，第四季則以 PCB 供應為主要觀察重點。價格策略方面，針對 Memory 與 SSD 的大幅漲價，公司已向客戶進行價格轉嫁；此外，主動、被動元件及 PCB 等非 Commodity 料件亦陸續調漲，部分漲幅達雙位數，公司已啟動第二波價格調整策略，並開始與全球客戶溝通。備料方面，工廠排程通常鎖定約四至六週，第二、三季約八成備料均有實際訂單支持，僅部分屬於確保供應的策略性備料。因預期第三季出貨將高於第二季，第三季備料金額亦將相對增加；下半年營運的主要挑戰仍在於能否於第四季取得足夠的關鍵料件，並將強勁訂單順利轉化為出貨。

Regional & Sector performances

[3.1] 第二季營收實現雙位數年增，主要由哪些產品線、終端應用或客戶需求所帶動？若排除 AI 相關專案，其他非 AI 業務的成長表現如何？

[3.2] 展望下半年，公司預期哪些區域市場及 Sector 應用領域的成長動能較為突出？上半年的需求動能是否具延續性？主要成長驅動因素是否仍來自 Edge AI 及 Physical AI 相關應用？

■ **Miller Chang** – President of Embedded Sector & **Linda Tsai** – President of Intelligent System & COO

上半年表現最突出的產品線為三層 Edge AI 架構最上層的 Server 及 Cloud 相關產品，營收成長均超過 100%；作為公司最大營收基礎的 Edge AI Computing 平台，包括板卡及系統等不同產品線，亦普遍成長 30%至 50%，整體表現相當強勁。新興應用方面，Robotics 及 Physical AI 目前營收占比仍低，但成長速度顯著；公司約三年前成立的機器人事業部，原訂 2026 年營收較 2025 年成長 100%，上半年實際增幅已超過 250%。其他垂直市

場中，半導體設備表現尤為突出，醫療設備及 Mission Critical 等嚴苛環境應用均呈現雙位數或高雙位數成長，Gaming 業務亦維持良好表現。相較之下，零售產業營收大致與去年持平，主要因零售客戶對價格較為敏感，在缺料及產品漲價影響下，部分客戶放緩設備汰換進度。展望下半年，依據第二季接單及目前訂單能見度，整體成長動能可望延續上半年，甚至進一步增強；美國、中國及歐洲三大主要市場，以及台灣、韓國及日本等中型市場均維持正向，其中台灣、韓國、美國及中國表現可望持續強勁，日本雖然上半年成長相對溫和，但近期第二季接單明顯增加，預期下半年將加速回升。主要成長動能仍來自 AI 於各產業的落地需求，包括三層 Edge AI 硬體架構、AI Factory 及 Robotics 等 Physical AI 應用，公司亦將持續擴大資源投入，以掌握相關長期商機。半導體設備及 AI Data Center 基礎建設需求亦可望延續，由於上下游交期普遍拉長，公司今年訂單已大致到位，部分策略型大客戶甚至已開始討論 2027 年關鍵料件需求及供應保障，進一步提升中期營運能見度。除直接的 AI 相關需求外，Network Security 與 Enterprise Storage 亦為重要成長來源；隨 Cybersecurity 重要性持續提升，公司所提供的 Server 等級網路安全產品在美國、歐洲及韓國市場均有強勁成長，企業儲存業務亦受客戶需求帶動，預期相關動能將延續至明年。半導體設備業務則主要聚焦台灣、韓國、日本及美國，公司將持續拓展全球前十大半導體設備商客戶，以擴大市場滲透率及長期成長基礎。

[3.3] 目前 design-win 進展如何？整體專案動能與未來轉換為營收的能見度為何？

■ Eric Chen – CFO & President of General Management

上半年研華於北美共取得 123 個 Design Win 專案，預估可貢獻年營收約 4.4 億美元；全年北美 Design Win 的潛在年營收貢獻有望突破 9 億美元。與去年同期相比，Design Win 專案件數成長 43%，預估年營收貢獻大幅成長 250%，顯示單一專案規模及整體專案價值均明顯提升。由於 Design Win 專案導入後的產品生命週期通常可達 5 至 8 年，預期將為公司帶來具延續性及長期能見度的營收貢獻。

Long-term Strategy

[4.1] 公司提到邊緣 AI 需求加速落地，並推出 WEDA 平台整合 Agentic AI。請問目前 Edge AI 或 Physical AI 專案主要來自哪些應用領域（如智慧製造、機器人、醫療、零售等）？預期今年下半年至明年，哪些領域的成長最快、最有機會成為新的營運動能？

■ KC Liu – Chairman

研華以「智能地球的推手（Enabling an Intelligent Planet）」為企業使命，相關布局與決策著重於能否為各產業的智慧化轉型創造價值，而非僅以短期營收規模作為考量，業務範圍則明確聚焦 B2B 市場。現階段訂單主要來自公司長期累積的產品、客戶與市場基礎，並非刻意集中資源於特定產業；就 AI 導入速度而言，預期製造、能源及醫療將相對領先。製造與能源產業的 AI 應用需求明確，且導入後可創造顯著效益；醫療產業則因護理人力長期短缺，運用 AI 協助處理部分護理及行政工作、讓人力集中於關鍵病患照護的需求強烈，加上醫院具備相

對充足的投資能力，因此亦為公司看好的市場。相較之下，零售、環保及交通等產業因獲利能力及投資預算較為有限，通常需先確認實際效益才會導入，預期將待 AI 技術與商業模式更成熟後才會加速發展。整體而言，各產業對 AI 導入的關注度及急迫性均相當高，企業普遍擔心在數位轉型過程中落後競爭者；因此，研華推動 IWS 軟硬體一體化方案，旨在降低工廠、醫院等產業導入 AI 的複雜度與技術門檻，加速 AI 應用於企業現場落地。

[4.2]請說明中長期角度，研華在企業傳承接班的規劃與主要行動

■ KC Liu – *Chairman*

預計於 2026 年底完成 CEO 職務交棒，目前三位總經理的接班運作順利，KC 未來三年仍將續任董事長。年底前的重要任務之一，是完成 WWBO 全球海外營運總部架構，進一步提升海外營運的制度化與組織完整性；目前美國、中國及歐洲的營運架構已相對成熟，未來將加強東南亞、印度及中東等市場布局。自 2027 年起，劉克振將專任董事長並投入更多心力於品牌經營及新事業發展。